WS 2013/2014 Ausgabe am: 27.01.2014

## Übungsblatt 12

## Aufgabe 1) npn-Transistor

Gegeben ist ein npn-Si-Transistor in Emitterschaltung bei einer Temperatur von T = 300K mit einer Basisweite von  $w = 2 \cdot 10^{-4}$  cm und einer Stromverstärkung  $\beta_0 = 50$  nach folgendem Ersatzschaltbild:

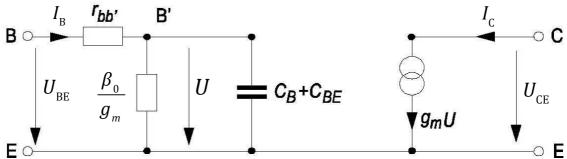


Fig. 1: Ersatzschaltbild eines npn-Transistors in Emitterschaltung

Es fließt ein Kollektorstrom von  $I_C = 2.5$  mA. Die Diffusionskonstante für Elektronen in der Basis ist  $D_{\rm npB} = 25 \, {\rm cm}^2/{\rm s}$ . Der gesamte Basis-Bahnwiderstand wird mit  $r_{\rm bb'} = 20 \, \Omega$  angenommen.

Hinweis: Benutzen zur Bestimmung von  $g_m$  folgende Gleichung aus dem Skript:

$$g_{m} = \frac{dI}{dU}\bigg|_{U_{0}} \approx \frac{\left|I_{c}\right|}{U_{T}} \tag{1.1}$$

- a) Berechnen Sie die Eingangsimpedanz  $U_{BE}/I_{B}$  für  $f \rightarrow 0$ ?
- b) Berechnen Sie die an den Transistorklemmen wirksame Steilheit  $g_m^* := \frac{I_c}{U_{BE}}\Big|_{U=0}$  im
  - Grenzfall kleiner Frequenzen, also für  $f \rightarrow 0$ ?
- c) Berechnen Sie die Basiskapazität  $C_B$ . Wie groß ist die Transitfrequenz  $f_T$  des Bauteils unter der Annahme, dass die Basiskapazität  $C_B$  sehr viel größer ist als die Basis-Emitter Kapazität  $C_{BE}$ ?
- d) Zeichnen Sie anhand der Skizze das Niederfrequenz-Ersatzschaltbild für die Basisschaltung. Berechnen Sie die Eingangsimpedanz  $U_{\rm EB}/I_{\rm E}$  für  $f \to 0$ . Erläutern Sie anhand des Ersatzschaltbildes das Zustandekommen einer negativen Eingangsimpedanz.

## **Aufgabe 2) MIS-Struktur**

Eine MIS-Struktur besteht aus einem Metall, einem raumladungsfreien Isolator der Dicke  $d_{\rm I}=100\,{\rm nm}$  und einem Halbleiter. Der Halbleiter hat eine Dotierung von  $n_{\rm D}=5\cdot 10^{16}\,{\rm cm}^{-3}$  (Annahme: Störstellenerschöpfung,  $n_i=1.5\cdot 10^{10}\,{\rm cm}^{-3}$  und einen Bandabstand von  $W_{\rm G}=1\,{\rm eV}$ . Die Elektronenaffinitäten von Halbleiter und Isolator weisen eine Differenz von  $W_{\chi,\rm HL}-W_{\chi,\rm Isolator}=1\,{\rm eV}$  auf. Die Differenz der Elektronenaffinität des Isolators und der Austrittsarbeit des Metalls beträgt  $W_{\chi,\rm Metal}-W_{\chi,\rm Isolator}=2\,{\rm eV}$ . Im Folgenden bezeichnen  $x=x_{\rm M-I}=0\,{\rm und}\ x=x_{\rm I-HL}=d_{\rm I}$  die Grenzflächen zwischen Metall und Isolator bzw. zwischen

Isolator und Halbleiter, siehe Fig. 2.

- a) Im thermischen Gleichgewicht ohne angelegte äußere Spannung sei der Halbleiter am Übergang zum Isolator eigenleitend, d.h.  $n(x_{\text{I-HL}}) = n_{\text{i}}$ . Wie groß ist die Potentialdifferenz  $\varphi_H = \varphi(x_{\text{I-HL}}) \varphi(x \to \infty)$  zwischen dem ungestörten HL und der Grenzfläche zum Isolator?
- b) Welchen Energieabstand hat das Ferminiveau zum Leitungsband, wenn die äquivalenten Zustandsdichten in den Bändern gleich groß sind? Betrachten Sie eine Stelle weit entfernt vom Übergang zum Isolator, an der die Bänder nicht verbogen sind.
- c) Skizzieren Sie die Bandverläufe im thermischen Gleichgewicht in die untenstehende Zeichnung. Mit welcher äußeren Spannung  $U = U_{\rm FB}$  zwischen Metall und Halbleiter erreicht man den Flachbandfall?

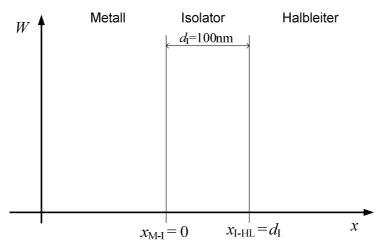


Fig. 2: Dimensionen der MIS Struktur